

2025年度校园招聘需求信息表

部门	招聘方向	联系方式
微电子器件与集成技术研发中心	芯片电路设计、算法；存储器存算一体技术；新范式智能计算芯片与系统；嵌入式存储器研究；自旋转矩磁性随机存储器；新型磁电耦合及自旋电子器件	张老师， zhangkangwei@ime.ac.cn
系统封装与集成研发中心	先进封装集成设计；三维异质异构集成可靠性研究；微电子、化学、高分子材料；物理、磁材料合成；磁性元件设计；磁性薄膜制备；电力电子技术；功率集成电路设计；机械自动化；MEMS传感；3D异质异构集成；微系统散热	尹老师， yinwen@ime.ac.cn
集成电路先导工艺研发中心	纳米CMOS器件及集成工艺研发；三维逻辑器件关键技术及集成工艺研发；SRAM研发制造；先进逻辑器件可靠性研究；硅基光电集成；晶圆工艺工程师；工艺线操作人员；工艺研发整合工程师；客户工程师	icachr@ime.ac.cn
EDA中心	先进器件工艺仿真建模及工具开发、电子设计自动化EDA技术、集成电路设计与IP核开发、设计与工艺协同优化、EDA软件开发	李老师，010-82995812， 13811785166 lizhiqiang@ime.ac.cn
抗辐照器件技术重点实验室	数字电路设计；模拟电路设计；PCB板级测试；射频芯片设计；接口电路设计；存储器设计；功率电路设计；计算机科学与技术；物理/应用物理；材料工程	高老师，13810023672， gaojiantou@ime.ac.cn
智能感知芯片与系统研发中心	人工智能芯片设计；低功耗集成电路设计；数字集成电路设计；模拟集成电路设计；射频集成电路设计；系统硬件设计；嵌入式音视频设计；人工智能算法设计	何老师， hehuan@ime.ac.cn
通信与信息工程研发中心	通感一体化；分布式组网；智能芯片；人工智能；多模态大模型；类脑智能	高老师， gaoxingyu@ime.ac.cn
高频高压器件与集成研发中心	超宽/宽禁带化合物半导体器件和电路；高速高精度ADC模拟及数字电路设计；高性能GaN基电力电子和射频微波器件；Si基GaN智能功率集成电路；III族氮化物半导体电子器件的先进制备工艺；表征技术及器件物理GaN射频微波器件关键工艺开发；GaN微波器件与电路设计；GaN微波器件与电路测试表征及可靠性；宽禁带半导体异质集成	常老师， changhudong@ime.ac.cn
微电子仪器设备研发中心	模型、软件算法；MEMS器件研发与电路开发；CMOS-MEMS设计研究；精密光学仪器系统、光学仪器、光学结构设计；光学仪器平台的搭建、实验、系统集成和数据分析	远老师， yuanyan@ime.ac.cn
光电技术研发中心	光学检测；光机精密设计；光学测量与软件；机器视觉；高速信号处理；高速嵌入系统研发；电子自动测试	姚羽，13811147689， yaoyu2020@ime.ac.cn
	极紫外光刻；光学检测；精密仪器	韩老师，18611551425， hanxuerong@ime.ac.cn
	光子集成设计；光电系统设计研究	乔老师，13240946662， qiaozhi@ime.ac.cn
	固体激光技术；微纳光子；泵浦激光器	崔老师，18810008217， cuihuirong@ime.ac.cn
新技术开发部	存储器芯片设计技术研究；固态存储可靠性及纠错系统研究；基于NAND闪存的存算一体架构研究；高性能系统芯片研究；新型存储器的器件制备、电输运测试及物理机理分析等	王老师，010-82995868， 13810608169， wangsining@ime.ac.cn
	电路与系统、自动化、光刻技术	齐老师，82995873， qiyuejing@ime.ac.cn